

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



香港聯交所股票代號：1347

新聞稿

華虹半導體二零一六年第四季度業績公佈

所有貨幣以美元列帳，除非特別指明。

本合併財務報告系依香港財務報告準則編製。

中國香港 — 2017年2月14日 — 全球領先的200mm純晶圓代工廠華虹半導體有限公司（香港聯交所股票代號：1347）（「本公司」）於今日公佈截至二零一六年十二月三十一日止三個月的綜合經營業績。

二零一六年第四季度主要財務指標

- 銷售收入再創歷史新高，達1.940億美元，環比增長4.7%，同比增長39.2%。
- 毛利率31.0%，環比持平，同比上升1.5個百分點。
- 期內溢利3,820萬美元，環比上升28.1%，同比上升83.1%。
- 每股盈利0.04美元，環比上升0.01美元，同比上升0.02美元。
- 淨資產收益率2.6%，環比上升0.6個百分點。

二零一六年度

- 銷售收入7.214億美元，較上年度增長11.0%。
- 毛利率30.5%，較上年度下降0.5個百分點。
- 年內溢利1.288億美元，較上年度上升14.5%。
- 每股盈利0.12美元，較上年度上升0.01美元。
- 淨資產收益率8.6%，較上年度上升1.0個百分點。

二零一七年第一季度指引

- 我們預計銷售收入在 1.82 億美元至 1.83 億美元之間，較本季度略有下降，主要由於受季節性因素和兩間工廠年度維護的影響。
- 我們預計毛利率約為 29%。

二零一六年度股利派發

- 根據已公佈的股利政策（連續三年所派股息的平均額將不低於該三年平均可分配淨利潤的 30%），公司將會在二零一七年五月召開的周年大會上決定二零一六會計年度股利分配方案。

本公司總裁兼執行董事王煜先生，對業績評論道：

“公司本季度的業績表現十分強勁。銷售收入上升至 1.940 億美元，環比增長 4.7%，超越了我們在二零一六年十一月公佈的指引。銷售收入的大幅增長主要得益於 MCU、智能卡芯片及分立器產品的需求增長，這些也正是本公司向來具有競爭優勢的領域。過去兩年間，我們的產能顯著擴充，且毛利率仍保持在 31%，這進一步證明了公司在提高產能利用率和持續優化產品結構方面所取得的成效。”

“全年來看”，王煜先生繼續說道，“二零一六年銷售收入和利潤均創歷史新高。銷售收入達 7.214 億美元，較上年度增長 11%。毛利率 30.5%，較上年度下降 0.5 個百分點，這主要是由於折舊成本上升，同時相當程度上被產能利用率的提高所抵銷。淨利潤率 17.9%，較上年度上升 0.6 個百分點。每股盈利 0.12 美元，上年度則為 0.11 美元。”

“我們完全相信，二零一七年又將是強勁成長的一年，” 王煜先生總結道，“我們預計，客戶對公司所專注的所有產品線的需求都將持續，尤其是 MCU、智能卡芯片、超級結、IGBT、模擬和電源管理芯片、及邏輯和無線電射頻產品。目前，我們的一些高增長、高毛利的產品將遷移至 90 納米工藝技術節點。因此，我們預計整體銷售價格和毛利都將繼續增長。”

電話會議公告

日期：二零一七年二月十五日

時間：下午 04:00（上海 / 香港）
上午 03:00（紐約，2017 年 2 月 15 日，星期三）

廣播：該電話會議將於下述網站進行語音及幻燈片直播：

http://www.huahonggrace.com/html/investor_webcast.php 或

https://engage.vevent.com/rt/huahongsemiconductor~2016_q4_earnings_call

電話詳細：

國際	+65 6713 5521
中國	+86 800 870 0531/+86 400 624 0406
香港	+852 3018 6768
臺灣	+886 277 031 751
紐約	+1 347 549 4095

電話會議登入名：63863512

密碼：HUAHONG

直播約 24 小時後，您可於 12 個月內在 http://www.huahonggrace.com/s/investor_webcast.php 網頁上，重複收聽會議。

關於華虹半導體

本公司是一家全球領先的 200mm 純晶圓代工廠。本公司在上海設有三家晶圓廠，主要專注製造特種應用的晶圓半導體。本公司生產的半導體被廣泛應用於不同市場各類產品，主要包括電子消費品、通訊、計算機、工業及汽車等。本公司採用自身的專有工藝及技術，為多元化客戶製造符合其設計規格的半導體，本公司亦提供設計支援服務，以便及時完成在工藝的性能、成本及製造成品率各方面均達致最優的複雜設計。

如需查詢詳細資訊，請登陸華虹半導體網站 <http://www.huahonggrace.com/>。

經營業績概要
(以千美元為單位，每股盈利和營運數據除外)

	二零一六年 第四季度 (未經審核)	二零一六年 第三季度 (未經審核)	二零一五年 第四季度 (未經審核)	環比	同比	二零一六年 年度 (未經審核)	二零一五年 年度 (已經審核)	同比
銷售收入	194,026	185,284	139,402	4.7 %	39.2 %	721,428	650,131	11.0 %
銷售成本	(133,946)	(127,749)	(98,290)	4.9 %	36.3 %	(501,080)	(448,705)	11.7 %
毛利	60,080	57,535	41,112	4.4 %	46.1 %	220,348	201,426	9.4 %
毛利率	31.0 %	31.1 %	29.5 %	(0.1)	1.5	30.5 %	31.0%	(0.5)
經營開支	(29,727)	(25,673)	(29,968)	15.8 %	(0.8)%	(104,218)	(112,147)	(7.1)%
其他收入淨額	14,440	4,796	14,244	201.1 %	1.4 %	37,350	35,973	3.8 %
稅前溢利	44,793	36,658	25,388	22.2 %	76.4 %	153,480	125,252	22.5 %
所得稅開支	(6,597)	(6,837)	(4,522)	(3.5)%	45.9 %	(24,648)	(12,703)	94.0 %
期/年內溢利	38,196	29,821	20,866	28.1 %	83.1 %	128,832	112,549	14.5 %
淨利潤率	19.7 %	16.1 %	15.0 %	3.6	4.7	17.9 %	17.3 %	0.6
每股盈利								
基本	0.04	0.03	0.02	33.3 %	100.0 %	0.12	0.11	9.1 %
攤薄	0.04	0.03	0.02	33.3 %	100.0 %	0.12	0.11	9.1 %
付運晶圓(仟片)	488	467	332	4.5 %	47.0 %	1,787	1,442	23.9 %
產能利用率 ¹	99.5 %	100.7 %	80.3 %	(1.2)	19.2	97.6 %	90.0 %	7.6
淨資產收益率 ²	2.6 %	2.0 %	1.4 %	0.6	1.2	8.6 %	7.6 %	1.0

二零一六年第四季度

- 銷售收入 1.940 億美元，環比增長 4.7%，同比增長 39.2%。
- 銷售成本 1.339 億美元，環比上升 4.9%，主要由於：(i)晶圓銷售量上升，(ii)計提年終獎金，及(iii)折舊和攤銷成本上升。
- 毛利率 31.0%，環比持平。
- 經營開支 2,970 萬美元，環比上升 15.8%，主要由於：(i)計提年終獎金，及(ii)計提設備減值準備，部分被增加的研發補助所抵銷。
- 其他收入淨額 1,440 萬美元，環比增加 201.1%，主要得益於：(i)匯兌收益，及(ii)分佔一家聯營公司盈利增加，部分被補貼收入減少所抵銷。
- 所得稅開支 660 萬美元，環比減少 3.5%，主要由於納稅扣除項的年終調整。
- 期內溢利 3,820 萬美元，環比上升 28.1%。
- 淨利潤率 19.7%，環比上升 3.6 個百分點。
- 每股盈利 0.04 美元，環比上升 0.01 美元。
- 淨資產收益率 2.6%，環比上升 0.6 個百分點。

¹產能利用率按平均月產量除以總估計月產能計算。

²期內溢利/加權平均淨資產。

二零一六年度

- 銷售收入達 7.214 億美元，較上年度增長 11.0%。
- 毛利率 30.5%，較上年度下降 0.5 個百分點，主要由於折舊和攤銷成本增加。
- 經營開支 1.042 億美元，較上年度下降 7.1%，主要由於：(i)計提設備減值準備減少，及(ii)研發補助增加。
- 其他收入淨額 3,740 萬美元，較上年度上升 3.8%。
- 所得稅開支 2,460 萬美元，較上年度上升 94.0%，主要由於上年度轉回代扣代繳股利所得稅。
- 年內溢利達 1.288 億美元，較上年度上升 14.5%。
- 每股盈利 0.12 美元，較上年度上升 0.01 美元。
- 淨資產收益率 8.6%，較上年度上升 1.0 個百分點。

銷售收入分析

按類別劃分的 銷售收入	二零一六年 第四季度 仟美元 (未經審核)	二零一六年 第四季度 % (未經審核)	二零一六年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零一六年 第三季度 % (未經審核)	環比 仟美元	環比 %
晶圓	189,972	97.9 %	180,388	97.4 %	9,584	5.3 %
其他	4,054	2.1 %	4,896	2.6 %	(842)	(17.2)%
銷售收入總額	194,026	100.0 %	185,284	100.0 %	8,742	4.7 %

- 本季度 97.9% 的銷售收入來源於半導體晶圓的直接銷售。

銷售收入分析

按地域劃分的 銷售收入	二零一六年 第四季度 仟美元 (未經審核)	二零一六年 第四季度 % (未經審核)	二零一六年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零一六年 第三季度 % (未經審核)	環比 仟美元	環比 %
中國 ³	106,801	55.1 %	98,621	53.2 %	8,180	8.3 %
美國	33,212	17.1 %	35,945	19.4 %	(2,733)	(7.6)%
亞洲 ⁴	24,821	12.8 %	24,561	13.3 %	260	1.1 %
歐洲	17,706	9.1 %	16,255	8.8 %	1,451	8.9 %
日本 ⁵	11,486	5.9 %	9,902	5.3 %	1,584	16.0 %
銷售收入總額	194,026	100.0 %	185,284	100.0 %	8,742	4.7 %

³包括香港。

⁴不包括中國及日本。

⁵包括於 2013 年由一家總部位於美國的公司所收購的一家主要日本客戶。

- 本季度來自中國的銷售收入 1.068 億美元，占銷售收入總額的 55.1%，環比增長 8.3%，主要得益於智能卡芯片、邏輯、及超級結產品的需求增加。
- 本季度來自美國的銷售收入 3,320 萬美元，環比減少 7.6%，主要由於超級結產品的需求減少。
- 本季度來自歐洲的銷售收入 1,770 萬美元，環比增長 8.9%，主要得益於通用 MOSFET 產品的需求增加。
- 本季度來自日本的銷售收入 1,150 萬美元，環比增長 16.0%，主要得益於獨立非易失性存儲器和邏輯產品的需求增加。

銷售收入分析

按技術平臺劃分的 銷售收入	二零一六年 第四季度 仟美元 (未經審核)	二零一六年 第四季度 % (未經審核)	二零一六年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零一六年 第三季度 % (未經審核)	環比 仟美元	環比 %
嵌入式非易失性存儲	73,127	37.7 %	60,829	32.9 %	12,298	20.2 %
分立器	54,315	28.0 %	52,103	28.1 %	2,212	4.2 %
模擬與電源管理	34,822	17.9 %	40,742	22.0 %	(5,920)	(14.5)%
邏輯及射頻	25,931	13.4 %	25,460	13.7 %	471	1.8 %
獨立非易失性存儲器	5,439	2.8 %	5,343	2.9 %	96	1.8 %
其他	392	0.2 %	807	0.4 %	(415)	(51.4)%
銷售收入總額	194,026	100.0 %	185,284	100.0 %	8,742	4.7 %

- 本季度嵌入式非易失性存儲器銷售收入 7,310 萬美元，環比增長 20.2%，主要得益於 MCU 產品和智能卡芯片的需求增加。
- 本季度分立器銷售收入 5,430 萬美元，環比增長 4.2%，主要得益於通用 MOSFET 產品的需求增加。
- 本季度模擬與電源管理銷售收入 3,480 萬美元，環比減少 14.5%，主要由於模擬和 LED 照明產品的需求減少。

銷售收入分析

按工藝技術節點劃分的銷售收入	二零一六年 第四季度 仟美元 (未經審核)	二零一六年 第四季度 % (未經審核)	二零一六年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零一六年 第三季度 % (未經審核)	環比 仟美元	環比 %
0.13μm 及以下	66,588	34.3 %	59,205	32.0 %	7,383	12.5 %
0.15μm 及 0.18μm	34,069	17.6 %	30,776	16.6 %	3,293	10.7 %
0.25μm	4,590	2.4 %	4,728	2.6 %	(138)	(2.9)%
0.35μm 及以上	88,779	45.7 %	90,575	48.8 %	(1,796)	(2.0)%
銷售收入總額	194,026	100.0 %	185,284	100.0 %	8,742	4.7 %

- 本季度來自 0.13μm 及以下工藝技術節點產品的銷售收入 6,660 萬美元，環比增長 12.5%，主要得益於 MCU 產品和智能卡芯片的需求增加。
- 本季度來自 0.15μm 及 0.18μm 工藝技術節點產品的銷售收入 3,410 萬美元，環比增長 10.7%，主要得益於 MCU 產品的需求增加。
- 本季度來自 0.35μm 及以上工藝技術節點產品的銷售收入 8,880 萬美元，環比減少 2.0%，主要由於模擬產品的需求減少。

銷售收入分析

按終端市場分佈劃分的銷售收入	二零一六年 第四季度 仟美元 (未經審核)	二零一六年 第四季度 % (未經審核)	二零一六年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零一六年 第三季度 % (未經審核)	環比 仟美元	環比 %
電子消費品	134,437	69.3 %	123,216	66.5 %	11,221	9.1 %
通訊	27,119	14.0 %	28,039	15.1 %	(920)	(3.3)%
工業及汽車	21,775	11.2 %	22,769	12.3 %	(994)	(4.4)%
計算機	10,695	5.5 %	11,260	6.1 %	(565)	(5.0)%
銷售收入總額	194,026	100.0 %	185,284	100.0 %	8,742	4.7 %

- 電子消費品及通訊仍是我們的第一及第二大終端市場分佈，本季度合計貢獻 83.3%的銷售收入，上一季度為 81.6%。
- 本季度電子消費品銷售收入 1.344 億美元，環比增長 9.1%，主要得益於 MCU 產品、智能卡芯片及分立器芯片的需求增加。
- 本季度通訊產品銷售收入 2,710 萬美元，環比減少 3.3%，主要由於分立器芯片的需求減少。
- 本季度工業及汽車產品銷售收入 2,180 萬美元，環比減少 4.4%，主要由於超級結產品的需求減少。
- 本季度計算機產品銷售收入 1,070 萬美元，環比減少 5.0%，主要由於分立器芯片需求減少。

產能⁶及產能利用率

晶圓廠(仟片晶圓每月)	二零一六年 第四季度 (未經審核)	二零一六年 第三季度 (未經審核)	二零一五年 第四季度 (未經審核)
1 號晶圓廠	56	56	56
2 號晶圓廠	57	57	50
3 號晶圓廠	42	40	40
合計	155	153	146
產能利用率	99.5%	100.7%	80.3%

- 產能利用率由上季度的 100.7% 下降至本季度的 99.5%，主要由於一間工廠進行了定期維護所致。

付運晶圓

仟片晶圓	二零一六年 第四季度 (未經審核)	二零一六年 第三季度 (未經審核)	二零一五年 第四季度 (未經審核)	環比	同比
付運晶圓	488	467	332	4.5 %	47.0 %

- 本季度付運晶圓 488 仟片，環比增長 4.5%，主要得益於智能卡芯片、MCU 產品和分立器芯片的需求增加。

經營開支分析

以千美元計	二零一六年 第四季度 (未經審核)	二零一六年 第三季度 (未經審核)	二零一五年 第四季度 (未經審核)	環比	同比
銷售及分銷費用	2,003	1,633	2,215	22.7 %	(9.6)%
管理費用 ⁷	27,724	24,040	27,753	15.3 %	(0.1)%
經營開支	29,727	25,673	29,968	15.8 %	(0.8)%

- 經營開支 2,970 萬美元，環比上升 15.8%，主要由於：(i) 計提年終獎金，及(ii) 計提設備減值準備，部分被增加的研發補助所抵銷。

⁶ 期末月產能，且為比較目的，以 30 天作為計算基礎。

⁷ 管理費用包括確認為研發開支抵銷項目的政府補助。

其他收入淨額分析

以千美元計	二零一六年 第四季度 (未經審核)	二零一六年 第三季度 (未經審核)	二零一五年 第四季度 (未經審核)	環比	同比
租金收入	3,772	2,842	3,280	32.7 %	15.0 %
利息收入	1,367	1,214	1,631	12.6 %	(16.2)%
匯兌收益/(損失)	6,024	(370)	1,798	(1,728.1)%	235.0 %
分佔一家聯營公司溢利/(損失)	3,871	182	(783)	2,026.9 %	(594.4)%
財務費用	(874)	(1,016)	(1,669)	(14.0)%	(47.6)%
政府補貼	320	1,590	9,361	(79.9)%	(96.6)%
其他	(40)	354	626	(111.3)%	(106.4)%
其他收入淨額	14,440	4,796	14,244	201.1 %	1.4 %

- 本季度其他收入淨額 1,440 萬美元，環比增加 201.1%，主要得益于：(i)匯兌收益，及(ii)分佔一家聯營公司溢利增加，部分被補貼收入減少所抵銷。

現金流量分析

以千美元計	二零一六年 第四季度 (未經審核)	二零一六年 第三季度 (未經審核)	二零一五年 第四季度 (未經審核)	環比	同比
經營活動所得現金流量淨額	84,319	45,694	62,209	84.5 %	35.5 %
投資活動所(用)/得現金流量淨額	(23,060)	(124,414)	78,276	(81.5)%	(129.5)%
融資活動所用現金流量淨額	(86,424)	(1,008)	(63,000)	8,473.8 %	37.2 %
外匯匯率變動影響淨額	(8,766)	(2,995)	(1,016)	192.7 %	762.8 %
現金及現金等價物變動影響淨額	(33,931)	(82,723)	76,469	(59.0)%	(144.4)%

- 本季度經營活動所得現金流量淨額 8,430 萬美金，環比上升 84.5%，主要由於(i)貿易應收款項及應收票據回收加快，(ii)從一家關聯公司收回應收廠房租款，及(iii)獲得政府補助增加。
- 本季度投資活動所用現金流量淨額 2,310 萬美元，其中包括(i)設備投資支出 2,420 萬美元，(ii)定期存款投資支出 1,000 萬美元，部分被(i)收到用於購買設備的政府補助 1,020 萬美元，及(ii)利息收入 90 萬美元所抵銷。
- 本季度融資活動所用現金流量淨額 8,640 萬美元，用於償還(i)銀行貸款本金 8,550 萬美元，及(ii)銀行貸款利息 90 萬美元。

資本結構

以千美元計	於十二月三十一日 二零一六年 (未經審核)	於九月三十日 二零一六年 (未經審核)
資產總額	1,826,664	1,916,731
負債總額	337,978	410,175
所有者權益總額	1,488,686	1,506,556
資產負債率 ⁸	18.5%	21.4%

資本開支

以千美元計	二零一六年 第四季度 (未經審核)	二零一六年 第三季度 (未經審核)
資本開支	24,243	53,800

- 本季度資本開支 2,420 萬美元，上季度為 5,380 萬美元。

流動性分析

以千美元計	於十二月三十一日 二零一六年 (未經審核)	於九月三十日 二零一六年 (未經審核)
存貨	95,199	98,760
貿易應收款項及應收票據	106,078	110,947
預付款項、按金及其他應收款項	8,963	14,554
應收關聯方款項	37,752	43,895
已凍結存款及定期存款	125,547	115,677
現金及現金等價物	341,255	375,186
流動資產總額	714,794	759,019
貿易應付款項	64,790	65,173
其他應付款項、預收賬款及暫估費用	101,507	79,505
計息銀行借款	1,874	42,750
政府補助	35,863	47,116
應付關聯方款項	9,689	11,416
應付所得稅	24,222	19,968
流動負債總額	237,945	265,928
淨營運資金	476,849	493,091
速動比率	2.6x	2.5x
流動比率	3.0x	2.9x
貿易應收款項及應收票據周轉天數	56	56
存貨周轉天數	65	70

⁸ 資產負債率=負債總額/資產總額。

- 預付款項、按金及其他應收款項由上季度末的 1,460 萬美元下降至本季度末的 900 萬美元，主要由於對供應商的預付款減少所致。
- 應收關聯方款項由上季度末的 4,390 萬美元下降至本季度末的 3,780 萬美元，主要由於從一家關聯公司收回應收廠房租賃款。
- 其他應付款項、預收賬款及暫估費用由上季度末的 7,950 萬美元上升至本季度末的 1.015 億美元，主要由於：(i)計提年終獎金，及(ii)應付設備採購款增加。
- 計息銀行借款由上季度末的 4,280 萬美元下降至本季度末的 190 萬美元，主要由於本季度償還銀行借款。
- 政府補助由上季度末的 4,710 萬美元下降至本季度末的 3,590 萬美元，主要由於採購了研發項目所用設備。
- 應付關聯方款項由上季度末的 1,140 萬美元下降至本季度末的 970 萬美元，主要由於對一家關聯公司的貿易應付款減少。
- 應付所得稅由上季度末的 2,000 萬美元上升至本季度末的 2,420 萬美元，主要由於本季度計提所得稅開支所致。
- 本季度末淨營運資金 4.768 億美元，流動比率 3.0。
- 本季度貿易應收款項及應收票據周轉天數 56 天，環比持平。
- 本季度存貨周轉天數由上季度的 70 天縮短至本季度的 65 天，主要得益于晶圓銷售量上升。

上述公佈詳情請參閱華虹半導體網站 www.huahonggrace.com

華虹半導體有限公司
簡明損益表(以千美元計,每股盈利和股數除外)

	截至以下日期止三個月		
	於十二月三十一日 二零一六年 (未經審核)	於九月三十日 二零一六年 (未經審核)	於十二月三十一日 二零一六年 (未經審核)
銷售收入	194,026	185,284	139,402
銷售成本	(133,946)	(127,749)	(98,290)
毛利	60,080	57,535	41,112
其他收入及收益	12,034	6,001	16,696
投資物業的公平值收益	72	-	-
銷售及分銷費用	(2,003)	(1,633)	(2,215)
管理費用	(27,724)	(24,040)	(27,753)
其他費用	(663)	(371)	-
財務費用	(874)	(1,016)	(1,669)
分佔一家聯營公司溢利/(損失)	3,871	182	(783)
稅前溢利	44,793	36,658	25,388
所得稅開支	(6,597)	(6,837)	(4,522)
期內溢利	38,196	29,821	20,866
以下各方應佔利潤:			
母公司擁有人	38,196	29,821	20,866
非控股權益	-	-	-
持有人應佔每股盈利			
基本	0.04	0.03	0.02
攤薄	0.04	0.03	0.02
用於計算每股基本盈利的期內已發行普通股加權平均數	1,033,871,656	1,033,871,656	1,033,871,656
用於計算每股攤薄盈利的期內已發行普通股加權平均數	1,040,365,656	1,037,949,656	1,037,337,663

華虹半導體有限公司
簡明損益表(以千美元計, 每股盈利和股數除外)

	二零一六年 (未經審核)	二零一五年 (已經審核)
銷售收入	721,428	650,131
銷售成本	(501,080)	(448,705)
毛利	220,348	201,426
其他收入及收益	34,761	42,717
投資物業的公平值收益	72	58
銷售及分銷費用	(6,814)	(7,292)
管理費用	(97,404)	(104,855)
其他費用	(666)	(9)
財務費用	(3,873)	(7,754)
分佔一家聯營公司溢利	7,056	961
稅前溢利	153,480	125,252
所得稅開支	(24,648)	(12,703)
年內溢利	128,832	112,549
以下各方應佔利潤:		
母公司擁有人	128,832	112,549
非控股權益	-	-
持有人應佔每股盈利		
基本	0.12	0.11
攤薄	0.12	0.11
用於計算每股基本盈利的期內已發行普通股加權平均數	1,033,871,656	1,033,871,656
用於計算每股攤薄盈利的期內已發行普通股加權平均數	1,037,288,656	1,034,816,656

華虹半導體有限公司
簡明綜合財務狀況表(以千美元計)

	截至		
	於十二月三十一日 二零一六年 (未經審核)	於九月三十日 二零一六年 (未經審核)	於十二月三十一日 二零一五年 (已經審核)
資產			
非流動資產			
物業、廠房及設備	656,517	689,290	629,180
投資物業	169,074	175,562	180,542
預付土地租賃款項	20,071	21,015	22,120
無形資產	8,176	7,427	8,516
於聯營公司的投資	45,121	42,866	40,833
可供出售投資	203,330	211,222	217,214
長期預付款項	3,861	4,639	10,806
遞延稅項資產	5,720	5,691	4,692
非流動資產總額	1,111,870	1,157,712	1,113,903
流動資產			
存貨	95,199	98,760	107,081
貿易應收款項及應收票據	106,078	110,947	103,822
預付款項、按金及其他應收款項	8,963	14,554	9,408
應收關聯方款項	37,752	43,895	25,282
已凍結存款及定期存款	125,547	115,677	41,796
現金及現金等價物	341,255	375,186	510,441
流動資產總額	714,794	759,019	797,830
流動負債			
貿易應付款項	64,790	65,173	66,280
其他應付款項、預收賬款及暫估費用	101,507	79,505	84,474
計息銀行借款	1,874	42,750	42,750
政府補助	35,863	47,116	53,881
應付關聯方款項	9,689	11,416	8,965
應付所得稅	24,222	19,968	21,576
流動負債總額	237,945	265,928	277,926
流動資產淨額	476,849	493,091	519,904
總資產減流動負債	1,588,719	1,650,803	1,633,807
非流動負債			
計息銀行借款	90,757	136,797	137,871
遞延稅項負債	9,276	7,450	5,246
非流動負債總額	100,033	144,247	143,117
淨資產	1,488,686	1,506,556	1,490,690
權益和負債權益			
股本	1,550,164	1,550,164	1,550,164
儲備	(61,478)	(43,608)	(59,474)
權益總額	1,488,686	1,506,556	1,490,690

華虹半導體有限公司
簡明綜合現金流量表(以千美元計)

	截至以下日期止三個月		
	於十二月三十一日 二零一六年 (未經審核)	於九月三十日 二零一六年 (未經審核)	於十二月三十一日 二零一五年 (未經審核)
經營活動所得現金流量:			
稅前溢利	44,793	36,658	25,388
折舊及攤銷	23,512	21,166	19,247
應佔聯營公司(溢利)/虧損	(3,871)	(182)	783
營運資金的變動及其它	19,885	(11,948)	16,791
經營活動所得現金流量淨額	84,319	45,694	62,209
投資活動所(用)/得現金流量:			
購買物業、廠房及設備項目	(24,243)	(53,800)	(26,046)
其他投資活動所(用)/得的現金流量	1,183	(70,614)	104,322
投資活動所(用)/得現金流量淨額	(23,060)	(124,414)	78,276
融資活動所用現金流量:			
新增銀行貸款	-	-	38,961
償還銀行貸款	(85,500)	-	(100,226)
向股東支付股息	(4)	(20,517)	-
已凍結存款的減少	4	20,517	-
已付利息	(924)	(1,008)	(1,735)
融資活動所用現金流量淨額	(86,424)	(1,008)	(63,000)
現金及現金等價物(減少)/增加淨額	(25,165)	(79,728)	77,485
外匯匯率變動影響淨額	(8,766)	(2,995)	(1,016)
期初現金及現金等價物	375,186	457,909	433,972
期末現金及現金等價物	341,255	375,186	510,441

華虹半導體有限公司
簡明綜合現金流量表(以千美元計)

	二零一六年 (未經審核)	二零一五年 (已經審核)
經營活動所得現金流量:		
稅前溢利	153,480	125,252
折舊及攤銷	85,078	79,048
應佔聯營公司溢利	(7,056)	(961)
營運資金的變動及其它	(19,593)	(15,562)
經營活動所得現金流量淨額	211,909	187,777
投資活動所用現金流量:		
購買物業、廠房及設備項目	(172,636)	(183,083)
其他投資活動所用的現金流量	(60,762)	(24,575)
投資活動所用現金流量淨額	(233,398)	(207,658)
融資活動所用現金流量:		
新增銀行貸款	-	38,961
償還銀行貸款	(85,500)	(119,854)
向股東支付股息	(35,922)	-
已凍結存款的減少	(8)	-
已付利息	(3,911)	(7,800)
融資活動所用現金流量淨額	(125,341)	(88,693)
現金及現金等價物減少額	(146,831)	(108,574)
外匯匯率變動影響淨額	(22,355)	(27,758)
期初現金及現金等價物	510,441	646,773
期末現金及現金等價物	341,255	510,441

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事

張素心(董事長)

王煜(總裁)

非執行董事

陳劍波

馬玉川

森田隆之

葉峻

獨立非執行董事

張祖同

王桂壩太平紳士

葉龍堃

承董事會命

華虹半導體有限公司

張素心

董事長兼執行董事

中國 香港

二零一七年二月十四日